

# 超声波测厚仪 型号 ISU-800D



可穿透  
涂层测量

探头实时  
温度补偿

数据  
传输

内置  
蓝牙

- 符合超声波测厚仪国家计量校准规范
- 探头实时温度补偿, 消除探头温度变化引起的测量误差
- 支持单晶和双晶探头, 既可对超薄工件进行精确测量, 又能兼顾大量程测量
- 可穿透涂层测量
- 测量模式: 常规厚度测量(双晶探头P-E模式、单晶测头I-E模式);  
穿透涂层厚度测量(双晶探头I-E模式、单晶测头E-E或AUTO模式)
- 测量方式: 单点测量、扫描测量、差值测量
- 设定上下限, 超限报警
- 具有单点校准和两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正
- 支持键盘锁功能, 避免测量过程中误触导致参数设置变化
- 可存储1000组测量数据
- 内置蓝牙模块及Mini-USB接口, 与电脑连接进行有线、无线数据传输



探头ISU-S15-P06(标配)



ISU-S15-P06-CB(选配)



ISU-S15-P06-CB1(选配)



## 技术参数

测量范围	参见探头技术参数
分辨率	0.01mm/0.001mm
测量精度	参见探头技术参数
数据输出	蓝牙和USB
声速范围	1~19999m/s
电源	内置3.7V可充电锂离子电池
尺寸	157×78×37mm
重量	260g

探头ISU-H3M-P12(选配)



探头ISU-S2M-P14(选配)



探头ISU-G5M-P10(选配)



探头ISU-G5M-P08(选配)



探头ISU-G7M-P06(选配)



探头ISU-G2M-P12(选配)



## 标准配置

主机	1个
探头ISU-S15-P06	1个
电源适配器	1个
USB线	1个
耦合剂	1瓶

## 可选附件

探头	型号及参数见下方
高温耦合剂(适用于ISU-H3M-P12)	ISU-HT5-COULPLANT
热敏打印机(有线连接)	ISU-800D-PRINTER

## 探头技术参数(基于碳钢)

型号	探头类型	频率	直径(Ød)	测量范围	可测量最小管子(直径×壁厚)	测量精度	工作温度	应用
ISU-S15-P06(标配)	单晶	15MHz	8mm	I-E: 0.9~28mm E-E: 0.15~14mm	Ø10×1.5mm Ø15×0.35mm	±0.02mm/0.3%H*(取大值)	-10~60°C	高精度测量或测量超薄工件
ISU-S15-P06-CB(选配) (适用于ISU-S15-P06)**	-	-	5mm	I-E: 0.9~10mm E-E: 0.15~5mm	Ø10×1.2mm Ø15×0.35mm			高精度测量不规则曲面
ISU-S15-P06-CB1(选配) (适用于ISU-S15-P06)**	-	-	8mm	I-E: 0.9~38mm E-E: 0.3~19mm	-			高精度测量较厚工件
ISU-S2M-P14(选配)	单晶	2MHz	19mm	I-E: 30~2000mm E-E: 30~1000mm	-	±0.5%H*	-10~310°C	超厚工件
ISU-G5M-P10(选配)	双晶	5MHz	13mm	0.8~300mm	Ø25×3mm	±0.04mm(范围<10mm) ±H/333mm*(范围≥10mm)	-10~60°C	常规工件
ISU-G5M-P08(选配)	双晶	5MHz	11mm	0.8~225mm	Ø20×1.2mm			曲面及常规测量
ISU-G7M-P06(选配)	双晶	7.5MHz	9mm	0.8~50mm	Ø15×1.2mm			曲面及小工件
ISU-G2M-P12(选配)	双晶	2MHz	17mm	3~700mm	Ø30×4mm			±0.05mm/0.5%H*(取大值)
ISU-H3M-P12(选配)	双晶	3MHz	15mm	2~200mm	Ø25×3mm	±0.05mm/0.5%H*(取大值)	-10~310°C	高温工件

\* H是测量厚度, 单位mm

\*\* 可选延迟块, 适用于探头ISU-S15-P06